

**平安证券股份有限公司**  
**关于甬矽电子（宁波）股份有限公司**  
**2025 年度持续督导跟踪报告**

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责甬矽电子的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

**一、持续督导工作情况**

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与甬矽电子签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查，2025 年甬矽电子未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	经核查，2025 年甬矽电子未发生重大违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构与甬矽电子保持密切的日常沟通，通过定期或不定期回访、现场检查等方式持续关注甬矽电子生产经营、信息披露情况，对甬矽电子开展了持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	2025 年，保荐机构督导甬矽电子及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理	保荐机构督促甬矽电子依照相关

序号	工作内容	实施情况
	制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构督导甬矽电子建立健全并有效执行内控制度，甬矽电子的内控制度能符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促甬矽电子严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	2025年，保荐机构对甬矽电子的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	经核查，2025年甬矽电子及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	经核查，2025年甬矽电子及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	经核查，2025年甬矽电子未出现该等事项。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）公司不配合持	经核查，2025年甬矽电子未发生相关情况。

序号	工作内容	实施情况
	续督导工作（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	保荐机构制定了现场检查的相关工作计划，明确了现场检查工作要求并于2025年12月10日-2025年12月12日开展现场检查工作。经核查，保荐机构认为不存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项，公司治理及经营管理状况正常。2025年度，甬矽电子不存在需要专项现场检查的情形。

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现甬矽电子存在重大问题。

## 三、重点风险事项

甬矽电子面临的重点风险因素主要如下：

### （一）产品未能及时升级迭代及研发失败的风险

集成电路市场的快速发展和电子产品的频繁更新换代，使得公司必须不断加快技术研发和新产品开发步伐，如果公司技术研发能力和开发的新产品不能够满足市场和客户的需求，公司将面临技术研发和新产品开发失败的风险。

针对上述风险，公司未来将紧跟半导体行业技术发展趋势，及时了解和深入分析市场发展和客户需求的变化，加大集成电路先进封装技术的研发和产业化，分散和化解市场及研发风险。

### （二）经营风险

#### 1、原材料价格波动的风险

公司主要原材料包括基板、引线框架、镀钯铜丝、塑封树脂、导电胶等。公司原材料价格受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，若未来公司原材料价格出现大幅波动，而公司产品售价不能及时调整，将给公司的盈利能力造成不利影响。

## 2、客户集中度较高的风险

报告期内，客户集中度相对较高。若未来公司与下游主要客户合作出现不利变化，或原有客户因市场竞争加剧、宏观经济波动以及自身产品等原因导致市场份额下降，且公司未能及时拓展新客户，则公司将会存在收入增速放缓甚至下降的风险。

### （三）财务风险

#### 1、存货跌价风险

公司封装所需要的原材料品类较多，且基板、专用引线框架等主要原材料交付周期受市场供需关系影响波动较大。公司为了应对原材料供应的波动性，通常会根据客户订单预测情况备有一定量的安全库存。2023年至2025年，公司存货账面价值分别为35,785.55万元、36,732.11万元和51,055.75万元，占流动资产的比例分别为11.93%、12.03%和14.71%，主要由原材料、在产品、低值易耗品和库存商品等组成。针对存货中原材料余额较高的情况，公司会通过生产计划和供应链管理促使原材料库存保持合理水平。若市场环境发生重大变化，公司未能及时调整库存水平，则可能出现存货跌价的风险。

#### 2、毛利率波动风险

公司主营业务毛利率可能存在较大波动。公司产品毛利率同产能利用率、主要原材料价格波动、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时，由于公司封装产品型号众多，不同型号产品在生产加工工艺和所需原材料构成均存在一定差异，因此产品结构变化也会对公司主营业务毛利产生较大影响。若未来上述因素发生不利变化，比如产能利用率下降、主要原材料价格大幅上涨或市场需求萎缩导致产品价格下降等，则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

### （四）行业风险

#### 1、市场竞争风险

近年来，随着我国集成电路封测行业快速发展，吸引了众多的企业进入，同时智能手机、PC等消费类电子市场需求疲软，市场处于去库存阶段，公司未来

业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险，市场竞争的加剧，可能导致行业平均利润率下降，进而对公司销售额及利润率造成一定影响。对此，公司将持续加大研发投入，加强市场开拓，强化降本增效，提高产品价格竞争力，积极应对市场竞争。

## **2、行业波动及需求变化风险**

公司主营业务为半导体行业集成电路封装测试，集成电路行业的发展状况对公司的生产经营具有重大直接影响。集成电路行业具有与宏观经济同步的特征，其波动幅度甚至会超过全球经济波动幅度。若未来宏观经济形势变化，全球集成电路产业市场出现较大波动，将对公司经营业务和经营业绩带来较大的影响。

### **（五）宏观环境风险**

#### **1、地缘政治环境及全球经济波动的风险**

全球经济复苏仍面临不确定性，国际贸易摩擦和地缘政治等因素对我国半导体行业的发展提出了新的挑战。同时全球经济仍处于周期性波动当中，需求缓慢复苏，全球经济放缓可能对半导体行业带来一定的不利影响，进而间接影响公司的业绩。未来，若国内和国外经济持续低迷，可能导致消费者消费预期降低，进而持续影响半导体行业，对公司生产经营产生不利的影响。

#### **2、产业政策变化风险**

政府对集成电路行业的产业政策为我国集成电路封装测试企业提供了良好的政策环境，若国家产业政策发生不利变化，将对行业产生一定的影响。公司将持续关注市场动向、宏观经济形势、相关政策、客户需求等变化，并建立对标体系，及时调整经营发展目标和投资方向，降低相关市场风险带来的影响。

## **四、重大违规事项**

2025 年度，公司不存在重大违规事项。

## **五、主要财务指标的变动原因及合理性**

2025 年公司主要财务数据如下表所示：

### （一）主要会计数据

单位：元、%

主要会计数据	2025年	2024年	变动比例
营业收入	4,398,366,248.32	3,609,179,447.25	21.87
利润总额	35,560,850.64	20,533,295.41	73.19
归属于上市公司股东的净利润	81,728,642.56	66,327,532.77	23.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,943,577.13	-25,312,623.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,688,958,317.59	1,635,722,105.59	3.25
主要会计数据	2025年末	2024年末	变动比例
归属于上市公司股东的净资产	2,608,884,913.27	2,510,883,280.57	3.90
总资产	15,190,676,699.96	13,655,476,763.66	11.24

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	变动比例（%）
基本每股收益（元/股）	0.20	0.16	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.16	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.06	不适用
加权平均净资产收益率（%）	3.22	2.69	增加 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.85	-1.03	减少 0.82 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.63	6.00	增加 0.63 个百分点

### （三）主要会计数据和财务指标的变动说明

公司主要财务数据及财务指标变动的原因如下：

1、利润总额：主要系本报告期内营业收入的增加，规模效应逐步体现，以及收到政府补贴的增加所致；

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要系本报告期固定资产折旧大幅增加及研发费用增幅较大所致；

3、扣除非经常性损益后的基本每股收益：主要系本报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。

综上，公司 2025 年度主要财务数据及指标变动具备合理性。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）核心竞争力分析

#### 1、客户资源优势

凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、不断提升的量产能力和交付及时性，公司获得了集成电路设计企业的广泛认可，并同众多国内外知名设计公司缔结良好的合作关系。报告期内，公司围绕客户提供全方位服务，通过增强新客户拓展力度、加大新产品导入力度、提升产品品质、缩短供货周期、降低产品成本等多种方式，提升客户满意度，公司客户结构持续优化，与多家细分领域头部客户建立战略合作伙伴关系，并获得多家客户颁发的战略合作供应商、最佳合作供应商、优秀战略合作伙伴等荣誉。报告期内，公司共有 24 家客户销售额超过 5,000 万元，客户结构持续优化。

#### 2、技术及产品结构优势

公司系国家高新技术企业，公司 2020 年入选国家第四批“集成电路重大项目企业名单”。公司具备较强的技术研发能力，截至 2025 年 12 月 31 日，公司总计获得授权的发明专利 219 项，实用新型专利 335 项，外观设计专利 3 项，软件著作权 10 项；在高密度细间距凸点倒装产品（FC 类产品）、系统级封装产品、4G/5G 射频功放封装技术、高密度大尺寸框架封装产品、MEMS 封装产品、IC 测试等领域均拥有核心技术。公司“年产 25 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”被评为浙江省重大项目。

公司从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域，车间洁净等级、生产设备、产线布局、工艺路线、技术研发、业务团队、客户导入均以先进封装业务为导向，业务起点较高。因此与同行业竞争者相比，甬矽电子产品结构较为优化，销售收入主要来自于中高端封装产品，并在射频前端芯片封测、AP 类 SoC 芯片封测、触控 IC 芯片封测、WiFi 芯片封测、蓝牙芯片封测、MCU 等物联网 AIoT 芯片封测等新兴应用领域具有良好的市场口碑和品牌知名度。

### 3、人才优势

公司拥有完整高效的研发团队，并重视研发队伍的建设和培养，研发团队核心人员均具备丰富的集成电路封装测试行业技术开发经验。公司拥有专业的工程技术和生产管理团队，可以根据客户提出的各种封装测试要求及时做出响应，并根据市场需求对产品种类和产量进行快速调整。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有研发技术人员 1,123 人，占公司总人数的比例为 16.98%。

#### （二）核心竞争力的变化情况

本持续督导期间，甬矽电子的持续竞争力未发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

#### （一）研发支出及变化情况

报告期内，公司研发投入情况如下：

单位：元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	291,504,060.00	216,658,120.99	34.55
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	291,504,060.00	216,658,120.99	34.55
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.63	6.00	增加 0.63 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	不适用	不适用	不适用

本年度研发费用为 29,150.41 万元，较上年同期增长 34.55%，主要系本报告期公司加大研发投入，重视研发队伍的建设和培养，直接研发投入和研发人员职工薪酬的增加所致。

#### （二）研发进展

报告期内，公司新增申请发明专利 58 项，实用新型专利 69 项，软件著作权 2 项；新增获得授权的发明专利 61 项，实用新型专利 96 项，软件著作权 3 项。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计获得 557 项专利，其中获得授权的发明专利 219

项，实用新型专利 335 项，外观设计专利 3 项，以及软件著作权 10 项，整体技术水平及产业化能力处于行业内先进水平。

截至 2025 年 12 月末，公司正在研发的主要项目情况如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	工艺能力提升研究类项目(如大尺寸芯片、多芯片组合等)	投入研究超大尺寸芯片倒装工艺/多芯片组合底部填充工艺/晶圆级测试 wafer 位移数据识别系统/电镀锡球凸块产品热熔工艺/晶圆级植球产品金属结晶析出控制工艺/超窄切割道 laser 工艺/QFN 敏感 wafer 封装作业 padpeeling 工艺/超厚膜贴片埋线工艺/WettableFlank 产品深台阶工艺/WettableFlank 产品全自动退镀工艺/高可靠性覆膜工艺/皮秒镭射工艺/TR 背面 IR 工艺/0.1mm 超薄基板倒装工艺光感产品高 BNH 工艺/模组产品垂直打线工艺/PCB 高密度布线技术的研发/高可靠性键合弹坑试验方法/高密度、高性能 2D 封装体叠层中叠焊球技术的研发等	提升芯片封装工艺技术能力	行业先进	研发项目成果，将逐步转化应用在高级程度消费电子产品，以及向高可靠性/高质量要求的工规和车电产品应用
2	设计仿真技术研究类项目(如高速信号、散热研究等)	投入研究 HCoS-OR (RDLInterposer) 封装设计技术/PCIe 高速信号电源 PDN 阻抗优化设计/双面封装工艺/QFP 封装抗分层设计/多物理场仿真算法及软件研发/DDFMHD 框架设计能力建立等	提升封装芯片设计仿真能力	行业先进	应对在高密度、复杂设计时多物理场的建模仿真技术研发，成果将应用在新产品开发过程中
3	生产工艺效率提升研究类项目(如天车系统、协同、分析等)	投入研究晶粒在线显微自动分析仪器研发及应用//射频产品测试抗干扰工艺/WIFI 产品测试工艺/HBPOP 封装产品热形变测量工艺/球焊超大颗 QFN 高线位工艺/QFN 超厚产品 MD 工艺/车规产品高可靠性线材 WB 制程能力/小颗产品 (<3*3) 电磁屏蔽开发与工艺能力/超厚塑封体厚度/液态树脂快速封装方法/芯粒集成设计与工艺协同优化(DTCCO)关键技术研究/自动化生产天车系统导入开发等	提升生产及设计效率及品质，完善自动化建设	行业先进	推进封装生产线自动/高效化管理，提升生产效率同时提升产品品质
4	新材料应用开发类项目(如国产先进封装材料、传统封装材料等)	投入国产 PR 光刻胶薄胶导入工艺/国产 PR 光刻胶厚胶导入工艺/高导热 2WCDAF 材料工艺/高导热 3WQFN 塑封料工艺/国产 Non-IR 非一体背胶膜材料特性工艺/国产低模量 DAF 应用指纹产品/国产全烧结胶应用于 PA 产品开发导入/超小芯片应用绝缘胶/高性能低损耗 IC 封装基板封装工艺研发等	建立新材料技术储备及低成本材料应用开发	行业先进	结合封装产品结构/应用调整，及材料供应链策略，匹配需求新特性材料应用开发
5	新封装产品开发类项目(如 2.5D 封装、pop 产品等)	投入研究 HcoS-SI/OR/OT 产品工艺/HB-POP 堆叠工艺大颗超薄产品等	提升新产品研发能力及技术竞争力	行业先进	新产品研发覆盖消费电子/车电/IOT 等多领域，扩充产品线及提升在高端封测上的技术竞争力
6	新工艺能力研发类	提前布局进行高密度凸块及重布线技术/金属片挡墙电磁屏蔽工艺 SMT 表面贴装技术等研	提升新工艺开发能	行业先进	先进封装技术将广泛应用在消费

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	项目(如晶圆级封装等)	究,并在接下来的研发及生产过程中逐步推进量产	力及技术竞争力		电子/工控/通讯/大基建/物联网等各行各业,前景广阔

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况是否合规

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)1042号)同意,公司向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券(以下简称“可转债”),期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量为1,165,000手(11,650,000张)。本次发行的募集资金总额为人民币116,500.00万元,扣除不含税的发行费用13,701,179.22元,实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。上述募集资金已于2025年7月2日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验证报告》(天健验【2025】177号)。

截至2025年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元

发行名称	2025年度向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2025年7月2日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	116,500.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	1,370.12
二、募集资金净额	115,129.88
减:	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	59,052.85
暂时补流金额	39,989.68

现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2.00
加：	
募集资金利息收入	78.53
三、报告期期末募集资金余额	16,163.88

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：

单位：万元

发行名称		2025 年度向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2025 年 7 月 2 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金专户	交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行	30700622701 5003006794	0.93	使用中
甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金专户	中国农业银行股份有限公司余姚凤山支行	39633001040 014238	7,114.43	使用中
甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金专户	招商银行股份有限公司宁波分行营业部	57490805281 0003	2,955.51	使用中
甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金专户	兴业银行股份有限公司宁波余姚支行	38302010010 0234758	2.38	使用中
甬矽半导体（宁波）有限公司募集资金专户	交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行	30700622701 5003007844	6,090.64	使用中
合计	-	-	16,163.88	-

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

经核查，甬矽电子 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东为浙江甬顺芯电子有限公司，持有公司 74,210,000 股股份，持股比例为 18.08%。2025 年公司控股股东持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际控制人为王顺波先生，直接持有公司 3.91% 的股份，通过甬顺芯间接控制公司 18.08% 的股份，通过宁波甬鲸间接控制公司 3.72% 的股份，通过宁波鲸芯间接控制公司 3.54% 的股份，通过宁波鲸舜间接控制公司 2.40% 的股份，王顺波直接和间接合计控制公司 31.64% 的股份。

报告期内，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股变动情况如下：

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	2025 年股份 增减变动量	增减变动原因
王顺波	董事、董事长、 总经理	16,000,000	16,030,000	30,000	股权激励归属
徐林华	董事、副总经理	1,194,974	1,224,974	30,000	股权激励归属
徐玉鹏	职工代表董事、 副总经理、核心 技术人员	0	26,100	26,100	股权激励归属
金良凯	财务总监、副总 经理	0	19,800	19,800	股权激励归属
李大林	董事会秘书、副 总经理	355,490	587,390	231,900	股权激励归属
钟磊	核心技术人员	0	11,700	11,700	股权激励归属、 二级市场买卖
李利	核心技术人员	0	9,600	9,600	股权激励归属
何正鸿	核心技术人员	0	0	0	股权激励归属、 二级市场买卖

除上表所列情形外，2025 年公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在其他持股数量发生变化的情形，不存在质押、冻结或减持情况。

## 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于甬矽电子（宁波）股份有限公司  
2025 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



周超



夏亦男



2026 年 4 月 30 日